



## 2020年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2019年10月31日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 笹川 謙

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2019年11月12日

配当支払開始予定日

2019年11月25日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2020年3月期第2四半期の連結業績(2019年4月1日～2019年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第2四半期	508,442	26.4	102,454	41.6	106,692	41.1	78,722	41.8
2019年3月期第2四半期	691,034	33.7	175,418	42.2	181,247	47.3	135,294	49.2

(注) 包括利益 2020年3月期第2四半期 76,235百万円 (44.1%) 2019年3月期第2四半期 136,416百万円 (40.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期第2四半期	490.18	487.48
2019年3月期第2四半期	824.70	821.27

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年3月期第2四半期	1,167,578	803,177	67.9
2019年3月期	1,257,627	888,117	70.0

(参考) 自己資本 2020年3月期第2四半期 792,438百万円 2019年3月期 880,748百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期		413.00		345.00	758.00
2020年3月期		246.00			
2020年3月期(予想)				290.00	536.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

### 3. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日～2020年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,110,000	13.2	225,000	27.6	229,000	28.8	170,000	31.5	1,068.83

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

## 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

詳細は、「添付資料」10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2020年3月期2Q	165,210,911 株	2019年3月期	165,210,911 株
------------	---------------	----------	---------------

期末自己株式数

2020年3月期2Q	7,707,596 株	2019年3月期	1,252,517 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2020年3月期2Q	160,600,610 株	2019年3月期2Q	164,054,351 株
------------	---------------	------------	---------------

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2020年3月期2Q 472,910株、2019年3月期 249,701株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

## 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2019年10月31日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	10
(セグメント情報等)	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間の世界経済につきましては、総じて緩やかな拡大を続けておりますが、中国経済の先行きや英国のEU離脱の行方など不透明感が残っております。

当社グループの参画するエレクトロニクス産業におきましては、データセンター向け設備投資やスマートフォン需要は一時的な調整局面にあるものの、将来に向けては、次世代通信規格(5G)に加え、IoTや人工知能(AI)等の需要増を背景にしたメモリ向け設備投資の再拡大が期待できるなど、半導体製造装置市場は今後徐々に回復し、成長基調に転じると見込んでおります。

このような状況のもと、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高5,084億4千2百万円(前年同期比26.4%減)、営業利益1,024億5千4百万円(前年同期比41.6%減)、経常利益1,066億9千2百万円(前年同期比41.1%減)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は787億2千2百万円(前年同期比41.8%減)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

#### ① 半導体製造装置

ロジック/ファウンドリ系半導体に対する設備投資は堅調に推移しました。上記のとおり、DRAM、3次元構造のNANDフラッシュメモリにおいては一時的な調整局面にあるものの、需給バランスの改善により、今後は回復基調へ向かうものと見込んでおります。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、4,700億4百万円(前年同期比26.4%減)となりました。

#### ② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

モバイル用中小型パネル向けに加え、テレビ用大型液晶パネル向けの設備投資についても調整局面にありますが、期後半からは回復基調に転じるものと見込んでおります。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、383億3千万円(前年同期比26.9%減)となりました。

#### ③ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1億8百万円(前年同期比0.2%減)となりました。

(ご参考)

## 【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
売上高	691,034	587,205	508,442	292,021
半導体製造装置	638,457	528,323	470,004	271,866
日本	109,195	96,839	73,559	41,024
北米	74,406	57,524	87,444	58,893
欧州	49,101	44,012	34,709	14,439
韓国	175,545	129,877	73,321	36,418
台湾	74,372	88,549	97,046	48,713
中国	126,270	80,643	83,925	56,834
東南アジア他	29,564	30,875	19,997	15,542
FPD製造装置	52,468	58,793	38,330	20,101
その他	108	89	108	53
営業利益	175,418	135,152	102,454	59,901
経常利益	181,247	140,415	106,692	62,100
親会社株主に帰属する 四半期純利益	135,294	112,933	78,722	46,828

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## (2) 財政状態に関する説明

## ① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,117億7千万円減少し、8,711億2千6百万円となりました。主な内容は、有価証券に含まれる短期投資の減少895億円、受取手形及び売掛金の減少351億2千1百万円、現金及び預金の増加367億6千6百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から167億6千9百万円増加し、1,668億3千8百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から2億8千8百万円増加し、93億4千3百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から46億6千2百万円増加し、1,202億6千9百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から900億4千9百万円減少し、1兆1,675億7千8百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ65億2百万円減少し、2,983億7千9百万円となりました。主として、未払法人税等の減少304億7千5百万円、賞与引当金の減少145億1千3百万円、前受金の増加371億5千6百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ13億9千3百万円増加し、660億2千1百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ849億4千万円減少し、8,031億7千7百万円となりました。主として、自己株式の取得1,086億7百万円による減少、前期の期末配当566億5千1百万円の実施による減少、親会社株主に帰属する四半期純利益787億2千2百万円を計上したことによる増加によるものであります。この結果、自己資本比率は67.9%となりました。

## ② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ222億6千6百万円増加し、2,549億1百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資850億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ527億3千3百万円減少し、3,399億1百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ56億8千1百万円増加の1,412億2百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益1,066億2千9百万円、前受金の増加377億7千7百万円、売上債権の減少324億2千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額293億7千7百万円、たな卸資産の増加274億8千4百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として短期投資の減少による収入750億円、有形固定資産の取得による支出228億6千万円により、前年同期の529億8百万円の支出に対し505億7千7百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に自己株式の取得による支出1,086億7百万円、配当金の支払566億5千1百万円により、前年同期の619億5千万円の支出に対し1,654億3千2百万円の支出となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間につきましては、主力の半導体製造装置がロジック/ファウンドリ向けに好調だったことから、売上高は、当初予想を上回ることとなりました。利益面につきましても営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益それぞれ当初予想を上回る結果となりました。

また、通期連結業績予想につきましても、最新の顧客の設備投資動向と業績動向に鑑み、2019年4月26日に公表した数値を以下のとおり修正いたします。

## 2020年3月期第2四半期累計期間の連結業績

	当期上半期実績	前回予想 (2019年4月26日公表)
売上高	5,084億円 (前年同期比 26.4%減)	4,900億円
半導体製造装置	4,700億円 (前年同期比 26.4%減)	4,500億円
F P D製造装置	383億円 (前年同期比 26.9%減)	400億円
営業利益	1,024億円 (前年同期比 41.6%減)	850億円
経常利益	1,066億円 (前年同期比 41.1%減)	850億円
親会社株主に帰属する 四半期純利益	787億円 (前年同期比 41.8%減)	630億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## 2020年3月期通期の連結業績予想

	今回修正予想	前回予想 (2019年4月26日公表)
売上高	1兆1,100億円 (前期比 13.2%減)	1兆1,000億円
半導体製造装置	1兆350億円 (前期比 11.3%減)	1兆300億円
F P D製造装置	748億円 (前期比 32.8%減)	700億円
営業利益	2,250億円 (前期比 27.6%減)	2,200億円
経常利益	2,290億円 (前期比 28.8%減)	2,200億円
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,700億円 (前期比 31.5%減)	1,640億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。

従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	177,634	214,401
受取手形及び売掛金	146,971	111,849
有価証券	215,000	125,500
商品及び製品	234,102	255,119
仕掛品	62,785	66,840
原材料及び貯蔵品	57,331	54,419
その他	89,156	43,067
貸倒引当金	△84	△71
流動資産合計	982,897	871,126
固定資産		
有形固定資産	150,069	166,838
無形固定資産		
その他	9,054	9,343
無形固定資産合計	9,054	9,343
投資その他の資産		
その他	117,033	121,680
貸倒引当金	△1,426	△1,411
投資その他の資産合計	115,607	120,269
固定資産合計	274,730	296,451
資産合計	1,257,627	1,167,578

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	75,448	80,385
未払法人税等	57,671	27,195
前受金	77,247	114,404
賞与引当金	33,139	18,625
製品保証引当金	14,097	13,064
その他の引当金	5,111	1,034
その他	42,166	43,670
流動負債合計	304,882	298,379
固定負債		
その他の引当金	932	110
退職給付に係る負債	60,600	61,439
その他	3,094	4,472
固定負債合計	64,628	66,021
負債合計	369,510	364,400
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	748,827	769,946
自己株式	△11,821	△118,764
株主資本合計	869,977	784,154
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13,024	18,928
繰延ヘッジ損益	△34	14
為替換算調整勘定	4,366	△5,480
退職給付に係る調整累計額	△6,585	△5,178
その他の包括利益累計額合計	10,770	8,283
新株予約権	7,368	10,739
純資産合計	888,117	803,177
負債純資産合計	1,257,627	1,167,578

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
売上高	691,034	508,442
売上原価	406,925	303,922
売上総利益	284,109	204,520
販売費及び一般管理費		
研究開発費	57,338	56,896
その他	51,352	45,170
販売費及び一般管理費合計	108,691	102,066
営業利益	175,418	102,454
営業外収益		
為替差益	1,885	2,363
その他	4,052	2,316
営業外収益合計	5,938	4,680
営業外費用		
関税追加徴収額	—	173
自己株式取得費用	—	114
閉鎖拠点維持管理費用	33	—
その他	75	153
営業外費用合計	109	442
経常利益	181,247	106,692
特別利益		
固定資産売却益	2	2
特別利益合計	2	2
特別損失		
固定資産除売却損	146	65
特別損失合計	146	65
税金等調整前四半期純利益	181,103	106,629
法人税等	45,808	27,906
四半期純利益	135,294	78,722
親会社株主に帰属する四半期純利益	135,294	78,722

四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
四半期純利益	135,294	78,722
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,648	5,905
繰延ヘッジ損益	△422	63
為替換算調整勘定	4,188	△9,819
退職給付に係る調整額	970	1,389
持分法適用会社に対する持分相当額	34	△26
その他の包括利益合計	1,121	△2,487
四半期包括利益	136,416	76,235
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	136,416	76,235

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	181,103	106,629
減価償却費	10,718	12,835
のれん償却額	266	98
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△453	△14,290
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,999	△4,077
売上債権の増減額 (△は増加)	5,592	32,425
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,426	△27,484
仕入債務の増減額 (△は減少)	△26,535	7,073
未収消費税等の増減額 (△は増加)	28,861	21,351
前受金の増減額 (△は減少)	△2,310	37,777
その他	336	△2,945
小計	197,006	169,395
利息及び配当金の受取額	2,094	1,185
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△63,580	△29,377
営業活動によるキャッシュ・フロー	135,521	141,202
投資活動によるキャッシュ・フロー		
短期投資の増減額 (△は増加)	△28,500	75,000
有形固定資産の取得による支出	△22,330	△22,860
無形固定資産の取得による支出	△862	△1,107
その他	△1,215	△454
投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,908	50,577
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△5,001	△108,607
配当金の支払額	△56,947	△56,651
その他	△1	△173
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,950	△165,432
現金及び現金同等物に係る換算差額	746	△4,081
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	21,408	22,266
現金及び現金同等物の期首残高	257,877	232,634
現金及び現金同等物の四半期末残高	279,286	254,901

## (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2019年5月27日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により自己株式は、当第2四半期連結累計期間において106,942百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において118,764百万円となりました。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

会計方針の変更

(IFRS第16号「リース」の適用)

第1四半期連結会計期間より、一部の在外連結子会社は、IFRS第16号「リース」を適用し、原則としてすべての借手としてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上しております。

本基準の適用にあたっては、経過的な取扱いに従っており、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。使用権資産の測定にはリース負債と同額とする方法を採用しており、この結果、期首の利益剰余金への影響はありません。

なお、本基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。

(セグメント情報等)

## ① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

## ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	470,004	38,330	9,216	517,551	△9,108	508,442
セグメント利益	115,089	6,128	511	121,729	△15,099	106,629

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益の調整額△15,099百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△9,221百万円、及びその他の一般管理費等であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

## ③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。